

客户委托分析单

客户委托日期: ____ / ____ / ____ 取送件专线: 021-50793616, 021-50795506 单号:客 000501

委托公司		联络人		部门	
连络手机		联络电话			
e-mail		需报价单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
客户 需求 及 试片 说明	请说明该试片之产品型号、规格以利注记: <input type="checkbox"/> 附上客户内部委工单 No. _____			分析结果要求型式:	
	客户内部委工单: 型号: _____ Project Code: _____ 请款人: <input type="checkbox"/> 同上 <input type="checkbox"/> 其它 _____ 附注 1:FIB 案件请于五个工作日内回复良率, 否则将以良率 100%计价. 附注 2:FIB 案件经 Decap 或 Bonding 后若不回测, 恕无法给予补货, 将以良率 100%计价.			<input type="checkbox"/> 电子文件(low data) <input type="checkbox"/> 收费书面报告(FA report) _____份 <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 其它方式说明: _____	
委 托 项 目					
1. 非破坏性分析: <input type="checkbox"/> X-RAY <input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> OM 观察 (请附上检测位置说明)					
2. 化性	<input type="checkbox"/> Decap 后送回____颗 <input type="checkbox"/> Delayer: 内容 _____ <input type="checkbox"/> Decap 后做 FIB: <input type="checkbox"/> 去 ACF 胶____颗 Decap-> <input type="checkbox"/> 回测-> <input type="checkbox"/> FIB -> <input type="checkbox"/> 回测-> <input type="checkbox"/> 封装 <input type="checkbox"/> 取 Die _____颗 或其它 _____ <input type="checkbox"/> 去 Polyimide _____颗 (请注意 FIB 案件经 Decap 或 Bonding 后若不回测, 恕无法给予补货, 将以良率 100%计价) <input type="checkbox"/> Decap 后做 EMMI _____颗 DECAP 范围 <input type="checkbox"/> 全开 <input type="checkbox"/> 局部开 (请务必开出有金线的角落, <input type="checkbox"/> 取 Die 后立即封装____颗 用作 GDS 对位置) <input type="checkbox"/> 拍照: <input type="checkbox"/> Metal____层 <input type="checkbox"/> Cu____层 <input type="checkbox"/> poly <input type="checkbox"/> stain DECAP 前先磨薄 <input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 数位倍率: 50.100.200.500.1000.1500 <input type="checkbox"/> Backside EMMI.OBIRCH 样品制备(Die 厚度: _____) <input type="checkbox"/> 海报输出 (委外代送)				
3. FIB	工作内容 _____ GDS <input type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 有, 檔名: _____ 产品类型: _____ 良率预估 _____ 提供方式: <input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> USB 时数预估 _____ <input type="checkbox"/> FTP <input type="checkbox"/> 其它 _____ 数量 _____颗 备品 _____颗 制程材质: <input type="checkbox"/> 铝 包装方式: <input type="checkbox"/> 铜→ <input type="checkbox"/> 有加 AP <input type="checkbox"/> 有加 RDL <input type="checkbox"/> COB 高脚 / 平板子 制程尺寸: _____µm _____poly <input type="checkbox"/> PCB 板子 <input type="checkbox"/> DIE <input type="checkbox"/> metal <input type="checkbox"/> DIP <input type="checkbox"/> SOP 有无光阻: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有→ <input type="checkbox"/> 局部去除(用高阶机台) <input type="checkbox"/> QPN <input type="checkbox"/> BGA <input type="checkbox"/> 化性全部去除 <input type="checkbox"/> Wafer- _____吋 有无 Polyimide: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有→ <input type="checkbox"/> 局部去除 <input type="checkbox"/> 其它 _____ 有无 Care 阻质: <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 _____Ω FIB 后打线: (用高阶机台) <input type="checkbox"/> 化性全部去除 <input type="checkbox"/> 金线 <input type="checkbox"/> 铝线 <input type="checkbox"/> 铜线				
4. 材料分析	<input type="checkbox"/> Dual Beam FIB <input type="checkbox"/> X-section <input type="checkbox"/> SEM <input type="checkbox"/> EDX <input type="checkbox"/> XPS / ESCA <input type="checkbox"/> TEM <input type="checkbox"/> SIMS <input type="checkbox"/> EMMI <input type="checkbox"/> InGaAs <input type="checkbox"/> OBIRCH <input type="checkbox"/> Curve Tracer <input type="checkbox"/> TLP				
5. 整合	<input type="checkbox"/> Probe Station <input type="checkbox"/> Probing <input type="checkbox"/> 雷射切割 <input type="checkbox"/> 故障分析 (请附“F/A Service Request Form”) <input type="checkbox"/> 参数分析仪量测				
6. <input type="checkbox"/> 快速封装 (请附委托内容说明)					
7. <input type="checkbox"/> ESD 静电测试 (请附“电性测试委工单”) <input type="checkbox"/> Reliability Testing (请附委托内容说明)					
备注 (请注明实验条件规格): <input type="checkbox"/> 请工程师回电					
客户委托 签名 / 日期		送件人员 签名 / 日期			

※估计的機台使用時數以第一次結果交付為準。若需陪同上機再次觀察, 以實際使用時數收費, 本單僅供客戶委託分析參考使用。

※一般件交期五個工作天; 急件交期三個工作天(加收50%); 特急件交期一個工作天(加收100%)